

■ 許容損失について (WLCSP-20-P1)

WLCSP-20-P1パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

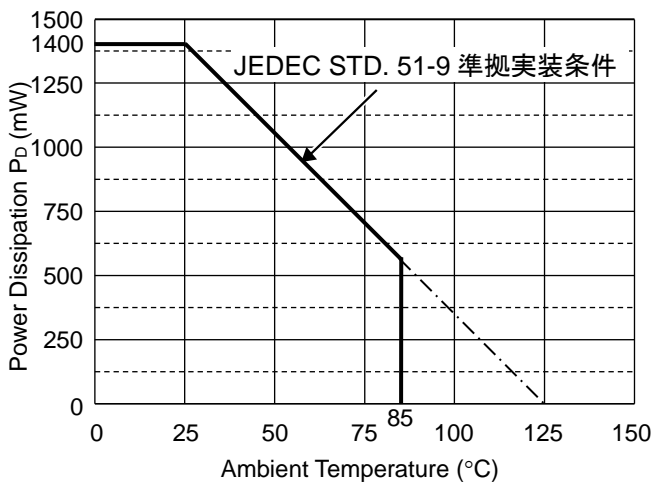
測定条件

JEDEC STD. 51-9 準拠実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	101.5 mm×114.5 mm×1.6 mm
配線率	表裏層: 配線率 60%以下 内層: 配線率 100%

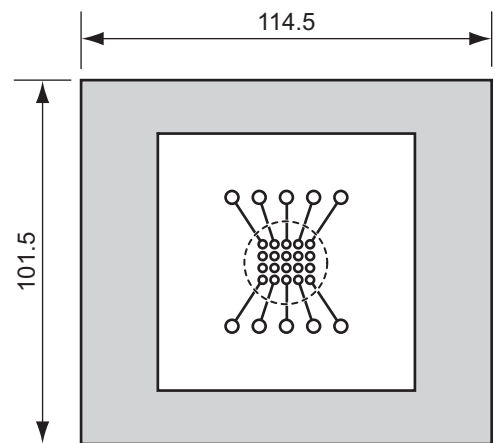
測定結果

(Ta=25°C, Tjmax=125°C)

JEDEC STD. 51-9 準拠実装条件	
許容損失	1400 mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125 - 25^\circ\text{C}) / 1.4 \text{ W} = 71^\circ\text{C/W}$



許容損失 対 周囲温度

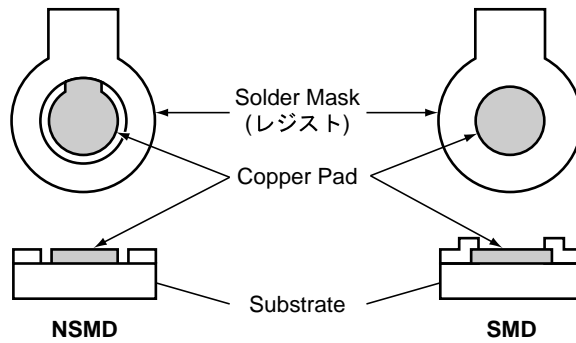


○ IC 実装位置

単位: mm

基板レイアウト

■ 基板パッド推奨寸法 (WLCSP)



NSMD and SMD Pad Definition

Pad definition	Copper Pad	Solder Mask Opening
NSMD (Non-Solder Mask defined)	0.24 mm	Min. 0.29 mm
SMD (Solder Mask defined)	Min. 0.29 mm	0.24 mm

パッド寸法の最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。

ステンシル開口部（推奨）… $\phi 0.265$ mm

Pbフリー製品については、共晶半田ペーストには実装しないようにして下さい。